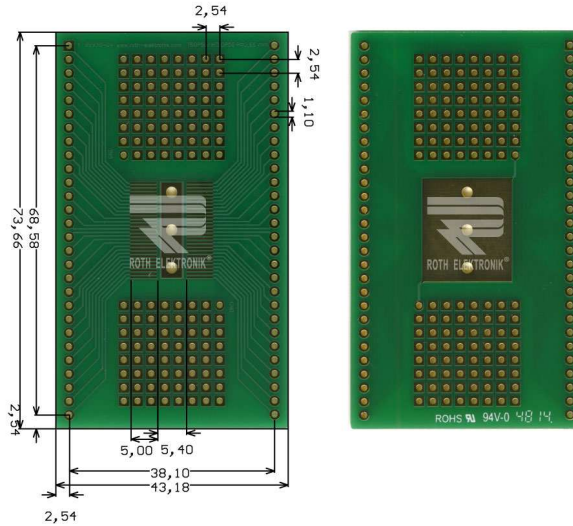


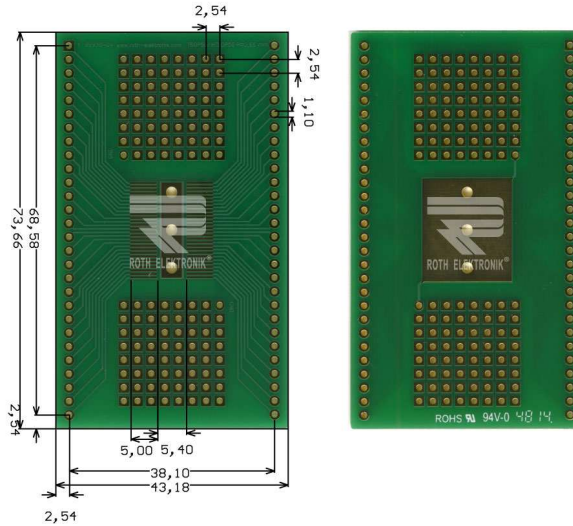
RE936-04

- Multiadapter TSOP 56 & HTSOP56
- Epoxy fibre-glass 1.50 mm
- Double-sided 35 µm Cu
- Plated through holes (PTH)
- Surface chem. Ni/Au
- Solder stop mask
- Adaption circuit board for SOP56 & HSOP56 with 0.65 mm pitch
- Hole spacing 2.54 mm
- Hole diameter Ø 1.10 mm with solder pads Ø 2.20 mm
- Two experimenting areas with 8 x 8 square pads 2.20 x 2.20 mm
- Shield pad & cooling pad
- Size 73.66 x 43.18 mm



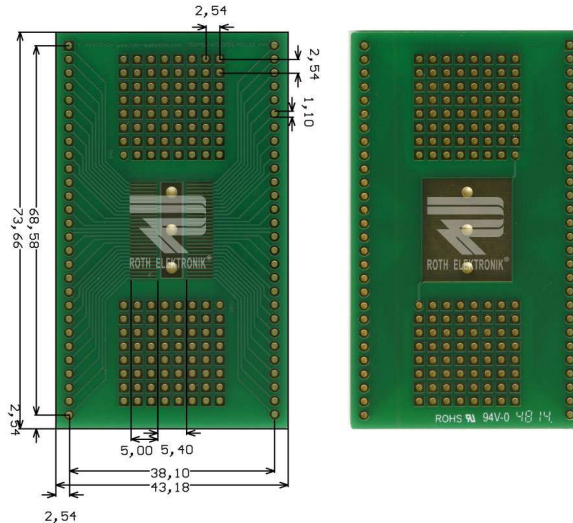
RE936-04

- Multiadapter für TSOP56 & HTSOP56
- Epoxydglashartgewebe FR4 1,50 mm
- Zweiseitig 35 µm Cu
- Durchkontaktiert (PTH)
- Oberfläche chem. Ni/Au
- Lötstopplack
- Adaptionsplatine für TSOP56 und HTSOP56 mit 0,65 mm Pitch
- Einreihig ausgeleitet in das Raster 2,54
- Bohrungen Ø 1,10 mm mit Lötinseln Ø 2,20 mm
- Zwei Experimentierfelder mit 8 x 8 quadratischen Lötinseln 2,20 x 2,20 mm
- Abschirmungsfeld und Kühlfläche
- Größe 73,66 x 43,18 mm



RE936-04

- Adaptateur multiple TSOP 56 & HTSOP56
- Fibre de verre époxyde 1.50 mm
- Double face 35 µm Cu
- Métallisation des trous (PTH)
- Surface avec Ni/Au chimique
- Masque de soudure
- Platine d'adaptation pour SOP56 & HSOP56 avec 0.65 mm pitch
- Pas 2.54 mm
- Perforation Ø 1.10 mm avec îlots de brasage Ø 2.20 mm
- Deux zones d'expérimentation avec des carrés de 8 x 8 2.20 x 2.20 mm
- Blindage et zone de refroidissement
- Dimensions 73.66 x 43.18 mm



RE936-04

- Multiadaptador para TSOP56 y HTSOP56
- Fibra de vidrio epoxídica FR4 1,50 mm
- Por dos lados 35 µm de Cu
- Agujeros con contactos metalizados (PTH)
- Superficie terminal química de Ni/Au
- Máscara de inhibidora de la soldadura
- Placa de circuito impreso de adaptación para TSOP56 y HTSOP56 con 0,65 mm Pitch
- Espacio entre orificios en una línea 2,54 mm
- Taladros de Ø 1,10 mm con nodos de soldadura Ø 2,20 mm
- Dos zonas de experimentación con 8 x 8 nodos de soldadura cuadrados de 2,20 x 2,20 mm
- Campo de apantallado y superficie de refrigeración
- Tamaño 73,66 x 43,18 mm